



光デバイス組立工程

徹底した選択と集中により高収益体質を目指す

電子デバイス事業では、「高収益体質の確立」を基本方針とし、成長市場への「徹底した選択と集中」によって、それぞれの市場でのナンバーワンを目指す戦略を展開しています。商品では特にシステムLSIとフラッシュメモリに集中し、これらに加えて化合物半導体、FCRAM(*1)/FRAM(*2)、SAW(*3)デバイスなどの高付加価値商品を展開することにより、ブロードバンド・インターネットの時代で成長の見込まれるモバイル、デジタル家電、ネットワーク向け市場での事業拡大を図っています。

投資面では、キャッシュフローの健全化を最重視し、注力商品への投資を優先し、また微細化投資の推進、協業およびファウンドリの活用、既存設備の徹底活用によって投資効率アップを図っています。協業については、米国アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD)とのフラッシュメモリの合弁事業、ソニーとのDRAM混載ロジックの開発・製造での協業、東芝および台湾ウインボンド・エレクトロニクスとの次世代FCRAM技術の共同開発などを推進しており、開発スピードアップ、商品競争力の強化を図っています。

商品別の事業戦略では、まずシステムLSIはデジタルAV、モバイル、WAN/ハイエンドLANなど高成長が見込まれる分野に経営資源を集中することで、収益性を一層高めていきます。急速に市場が拡大しているフラッシュメモリについては、携帯電話向けのほか、通信ネットワーク/デジタルAV機器向けなど、幅広い市場の開拓に努めています。富士通グループは、小型パッケージ化などの先進技術や生産能力でも他社をリードしているため、国内でトップシェアを確保、世界市場でもトップグループに入っており、今後はこ

れらの実績をもとにさらなる競争力強化を図っていきます。化合物半導体はブロードバンド化で拡大する高速・大容量の光伝送機器市場に注力しています。FCRAMについては、高速・低電力という特長を活かし、ネットワークや携帯電話市場向けにお客様のニーズを先取りした商品を他社に先駆けて開発し、提供しています。FRAMについても、eコマース、モバイルネットワークの発展に伴い一層の拡大が期待されるICカードやスマートカード市場に向けた拡販を進め、商品のデファクト・スタンダード化を推進してまいります。SAWデバイスは携帯機器市場でトップシェアを維持することで、高収益体質の確立を目指します。

開発・生産体制では、2000年7月に電子デバイスの開発拠点として「富士通あきる野テクノロジーセンター」を開設しました。プロセス開発部門・研究部門を集結、今後試作ラインも実装しプロセステクノロジーの開発スピードを早めてまいります。2000年7月にはフラッシュメモリの新工場として、富士通エィ・エム・ディ・セミコンダクタ(株)が会津若松市に第三工場の建設に着工、2001年8月から生産開始し、供給体制を強化いたします。次世代表示装置として注目の高まるプラズマ・ディスプレイ・パネル(PDP)については、富士通日立プラズマディスプレイ(株)が世界最大規模の量産工場を完成させ、2001年4月から製品出荷を開始しました。新工場では、従来の42型に加え、家庭市場向けの新製品32型/37型ハイビジョンPDPも生産。市場での優位性を一層強化してまいります。

(*1)FCRAM : Fast Cycle Random Access Memory

(*2)FRAM : Ferroelectric RAM. FRAMは米ラムトロン社の登録商標です。

(*3)SAW : Surface Acoustic Wave